Technische Information / Technical Information

IGBT-Modul
IGBT-Module

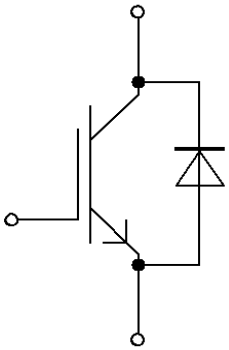
FZ400R12KS4P

62mm C-Serien Modul mit schnellem IGBT2 für hochfrequentes Schalten und bereits aufgetragenem Thermal Interface Material

62mm C-Series module with the fast IGBT2 for high-frequency switching and pre-applied Thermal Interface Material

Vorläufige Daten / Preliminary Data





V_{CES} = 1200V
$I_{C\ nom}$ = 400A / I_{CRM} = 800A

Typische Anwendungen

- Anwendungen für Resonanz Umrichter
- Anwendungen mit hohen Schaltfrequenzen
- Medizinische Anwendungen
- Motorantriebe
- Servoumrichter
- USV-Systeme

Typical Applications

- Resonant inverter applications
- High Frequency Switching application
- Medical applications
- Motor drives
- Servo drives
- UPS systems

Elektrische Eigenschaften

- Hohe Kurzschlussrobustheit
- Niedrige Schaltverluste
- Sehr große Robustheit
- V_{CEsat} mit positivem Temperaturkoeffizienten

Electrical Features

- High short-circuit capability
- Low switching losses
- Unbeatable robustness
- V_{CEsat} with positive temperature coefficient

Mechanische Eigenschaften

- Gehäuse mit CTI > 400
- Große Luft- und Kriechstrecken
- Isolierte Bodenplatte
- Kupferbodenplatte
- Standardgehäuse
- Thermisches Interface Material bereits aufgetragen

Mechanical Features

- Package with CTI > 400
- High creepage and clearance distances
- Isolated base plate
- Copper base plate
- Standard housing
- Pre-applied Thermal Interface Material

Module Label Code

Barcode Code 128

Sample
00000123456000000000000

DMX - Code

Content of the Code	Digit
Module Serial Number	1 - 5
Module Material Number	6 - 11
Production Order Number	12 - 19
Datecode (Production Year)	20 - 21
Datecode (Production Week)	22 - 23

prepared by: AKB	date of publication: 2016-06-14	
approved by: MK	revision: V2.0	UL approved (E83335)

Vorläufige Daten
Preliminary Data

IGBT,Wechselrichter / IGBT,Inverter

Höchstzulässige Werte / Maximum Rated Values

Kollektor-Emitter-Sperrspannung Collector-emitter voltage	T_{vj} = 25°C	V_{CES}	1200		V
Kollektor-Dauergleichstrom Continuous DC collector current	T_H = 35°C, $T_{vj\,max}$ = 150°C	$I_{C\,nom}$	400		A
Periodischer Kollektor-Spitzenstrom Repetitive peak collector current	t_P = 1 ms	I_{CRM}	800		A
Gate-Emitter-Spitzenspannung Gate-emitter peak voltage		V_{GES}	+/-20		V

Charakteristische Werte / Characteristic Values

			min.	typ.	max.	
Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung Collector-emitter saturation voltage	I_C = 400 A, V_{GE} = 15 V I_C = 400 A, V_{GE} = 15 V	T_{vj} = 25°C T_{vj} = 125°C	$V_{CE\,sat}$		3,20 3,85	3,70	V V
Gate-Schwellenspannung Gate threshold voltage	I_C = 16,0 mA, V_{CE} = V_{GE}, T_{vj} = 25°C		V_{GEth}	4,50	5,50	6,50	V
Gateladung Gate charge	V_{GE} = -15 V ... +15 V		Q_G		4,20		µC
Interner Gatewiderstand Internal gate resistor	T_{vj} = 25°C		R_{Gint}		1,3		Ω
Eingangskapazität Input capacitance	f = 1 MHz, T_{vj} = 25°C, V_{CE} = 25 V, V_{GE} = 0 V		C_{ies}		26,0		nF
Rückwirkungskapazität Reverse transfer capacitance	f = 1 MHz, T_{vj} = 25°C, V_{CE} = 25 V, V_{GE} = 0 V		C_{res}		1,70		nF
Kollektor-Emitter-Reststrom Collector-emitter cut-off current	V_{CE} = 1200 V, V_{GE} = 0 V, T_{vj} = 25°C		I_{CES}			5,0	mA
Gate-Emitter-Reststrom Gate-emitter leakage current	V_{CE} = 0 V, V_{GE} = 20 V, T_{vj} = 25°C		I_{GES}			400	nA
Einschaltverzögerungszeit, induktive Last Turn-on delay time, inductive load	I_C = 400 A, V_{CE} = 600 V V_{GE} = ±15 V R_{Gon} = 2,2 Ω	T_{vj} = 25°C T_{vj} = 125°C	$t_{d\,on}$		0,10 0,11		µs µs
Anstiegszeit, induktive Last Rise time, inductive load	I_C = 400 A, V_{CE} = 600 V V_{GE} = ±15 V R_{Gon} = 2,2 Ω	T_{vj} = 25°C T_{vj} = 125°C	t_r		0,06 0,07		µs µs
Abschaltverzögerungszeit, induktive Last Turn-off delay time, inductive load	I_C = 400 A, V_{CE} = 600 V V_{GE} = ±15 V R_{Goff} = 2,2 Ω	T_{vj} = 25°C T_{vj} = 125°C	$t_{d\,off}$		0,53 0,55		µs µs
Fallzeit, induktive Last Fall time, inductive load	I_C = 400 A, V_{CE} = 600 V V_{GE} = ±15 V R_{Goff} = 2,2 Ω	T_{vj} = 25°C T_{vj} = 125°C	t_f		0,03 0,04		µs µs
Einschaltverlustenergie pro Puls Turn-on energy loss per pulse	I_C = 400 A, V_{CE} = 600 V, L_S = 85 nH V_{GE} = ±15 V, di/dt = 4000 A/µs R_{Gon} = 2,2 Ω	T_{vj} = 25°C T_{vj} = 125°C	E_{on}		22,0		mJ mJ
Abschaltverlustenergie pro Puls Turn-off energy loss per pulse	I_C = 400 A, V_{CE} = 600 V, L_S = 85 nH V_{GE} = ±15 V R_{Goff} = 2,2 Ω	T_{vj} = 25°C T_{vj} = 125°C	E_{off}		29,0		mJ mJ
Kurzschlußverhalten SC data	$V_{GE} \leq$ 15 V, V_{CC} = 900 V $V_{CEmax} = V_{CES} - L_{sCE} \cdot di/dt$	$t_P \leq$ 10 µs, T_{vj} = 125°C	I_{SC}		2600		A
Wärmewiderstand, Chip bis Kühlkörper Thermal resistance, junction to heatsink	pro IGBT / per IGBT valid with IFX pre-applied thermal interface material		R_{thJH}			0,0617	K/W
Temperatur im Schaltbetrieb Temperature under switching conditions			$T_{vj\,op}$	-40		125	°C

prepared by: AKB	date of publication: 2016-06-14
approved by: MK	revision: V2.0

Vorläufige Daten
Preliminary Data

Diode, Wechselrichter / Diode, Inverter

Höchstzulässige Werte / Maximum Rated Values

Periodische Spitzensperrspannung Repetitive peak reverse voltage	T_{vj} = 25°C	V_{RRM}	1200	V
Dauergleichstrom Continuous DC forward current		I_F	400	A
Periodischer Spitzenstrom Repetitive peak forward current	t_P = 1 ms	I_{FRM}	800	A
Grenzlastintegral I²t - value	V_R = 0 V, t_P = 10 ms, T_{vj} = 125°C	I²t	35000	A²s

Charakteristische Werte / Characteristic Values

			min.	typ.	max.	
Durchlassspannung Forward voltage	I_F = 400 A, V_{GE} = 0 V I_F = 400 A, V_{GE} = 0 V	T_{vj} = 25°C T_{vj} = 125°C	V_F		2,00 1,70	2,40	V V
Rückstromspitze Peak reverse recovery current	I_F = 400 A, - di_F/dt = 4000 A/µs (T_{vj}=125°C) V_R = 600 V V_{GE} = -15 V	T_{vj} = 25°C T_{vj} = 125°C	I_{RM}		280 420		A A
Sperrverzögerungsladung Recovered charge	I_F = 400 A, - di_F/dt = 4000 A/µs (T_{vj}=125°C) V_R = 600 V V_{GE} = -15 V	T_{vj} = 25°C T_{vj} = 125°C	Q_r		24,0 64,0		µC µC
Abschaltenergie pro Puls Reverse recovery energy	I_F = 400 A, - di_F/dt = 4000 A/µs (T_{vj}=125°C) V_R = 600 V V_{GE} = -15 V	T_{vj} = 25°C T_{vj} = 125°C	E_{rec}		16,0 32,0		mJ mJ
Wärmewiderstand, Chip bis Kühlkörper Thermal resistance, junction to heatsink	pro Diode / per diode valid with IFX pre-applied thermal interface material		R_{thJH}			0,0915	K/W
Temperatur im Schaltbetrieb Temperature under switching conditions			$T_{vj\,op}$	-40		125	°C

Vorläufige Daten
Preliminary Data

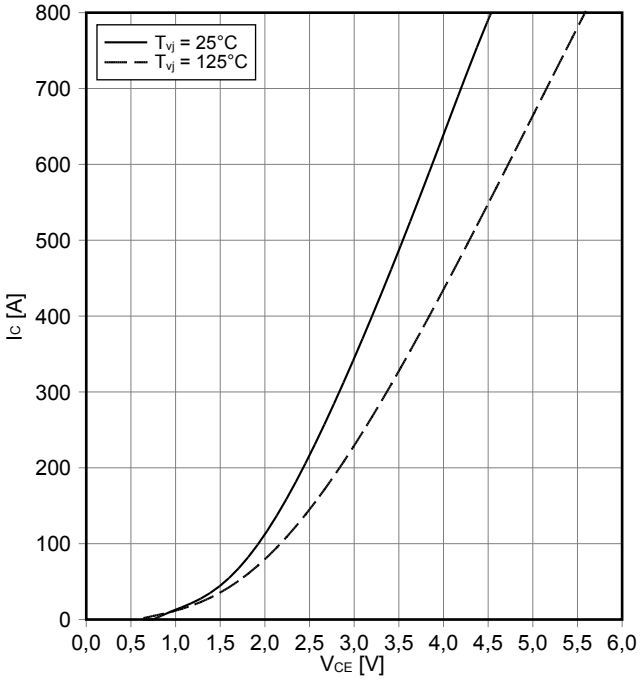
Modul / Module

Isolations-Prüfspannung Isolation test voltage	RMS, f = 50 Hz, t = 1 min.	V_{ISOL}		4,0		kV
Material Modulgrundplatte Material of module baseplate				Cu		
Innere Isolation Internal isolation	Basisisolierung (Schutzklasse 1, EN61140) basic insulation (class 1, IEC 61140)			Al_2O_3		
Kriechstrecke Creepage distance	Kontakt - Kühlkörper / terminal to heatsink Kontakt - Kontakt / terminal to terminal			25,0 19,0		mm
Luftstrecke Clearance	Kontakt - Kühlkörper / terminal to heatsink Kontakt - Kontakt / terminal to terminal			25,0 10,0		mm
Vergleichszahl der Kriechwegbildung Comperative tracking index		CTI		> 400		
			min.	typ.	max.	
Wärmewiderstand, Gehäuse bis Kühlkörper Thermal resistance, case to heatsink	pro Modul / per module λ_{Paste} = 1 W/(m·K) / λ_{grease} = 1 W/(m·K)	R_{thCH}		0,01		K/W
Modulstreuinduktivität Stray inductance module		L_{sCE}		16		nH
Modulleitungswiderstand, Anschlüsse - Chip Module lead resistance, terminals - chip	T_H = 25°C, pro Schalter / per switch	$R_{CC'+EE'}$		0,50		mΩ
Lagertemperatur Storage temperature		T_{stg}	-40		125	°C
Höchstzulässige Bodenplattenbetriebstemperatur Maximum baseplate operation temperature		T_{BPmax}			125	°C
Anzugsdrehmoment f. Modulmontage Mounting torque for modul mounting	Schraube M6 - Montage gem. gültiger Applikationsschrift Screw M6 - Mounting according to valid application note	M	3,00		6,00	Nm
Anzugsdrehmoment f. elektr. Anschlüsse Terminal connection torque	Schraube M4 - Montage gem. gültiger Applikationsschrift Screw M4 - Mounting according to valid application note Schraube M6 - Montage gem. gültiger Applikationsschrift Screw M6 - Mounting according to valid application note	M	1,1 2,5	- -	2,0 5,0	Nm Nm
Gewicht Weight		G		340		g

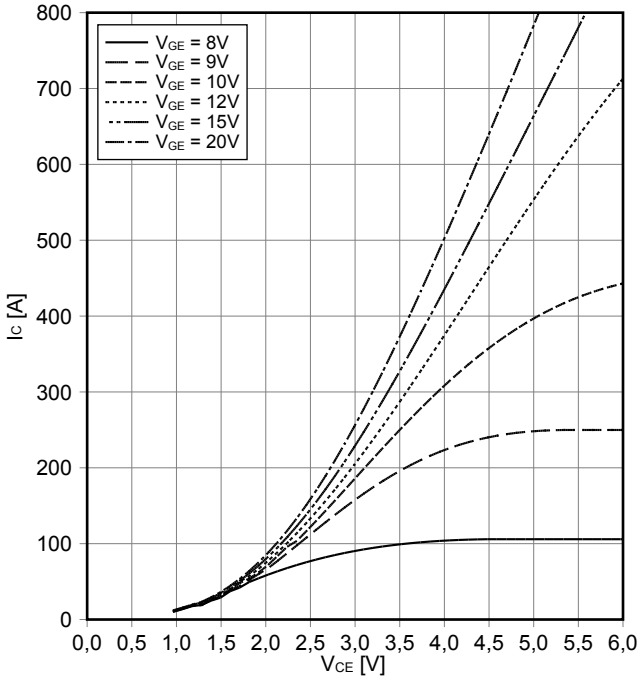
Lagerung und Transport von Modulen mit TIM => siehe AN2012-07
Storage and shipment of modules with TIM => see AN2012-07

Vorläufige Daten
Preliminary Data

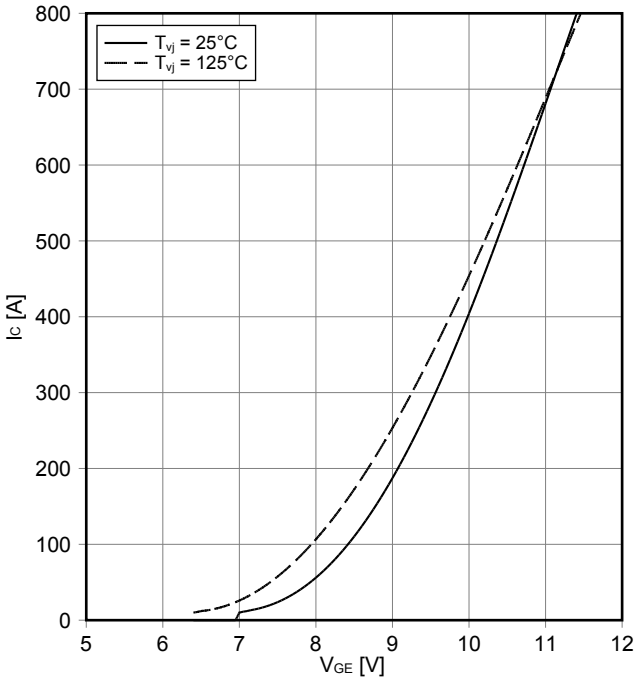
Ausgangskennlinie IGBT,Wechselrichter (typisch)
output characteristic IGBT,Inverter (typical)
$I_C = f(V_{CE})$
V_{GE} = 15 V



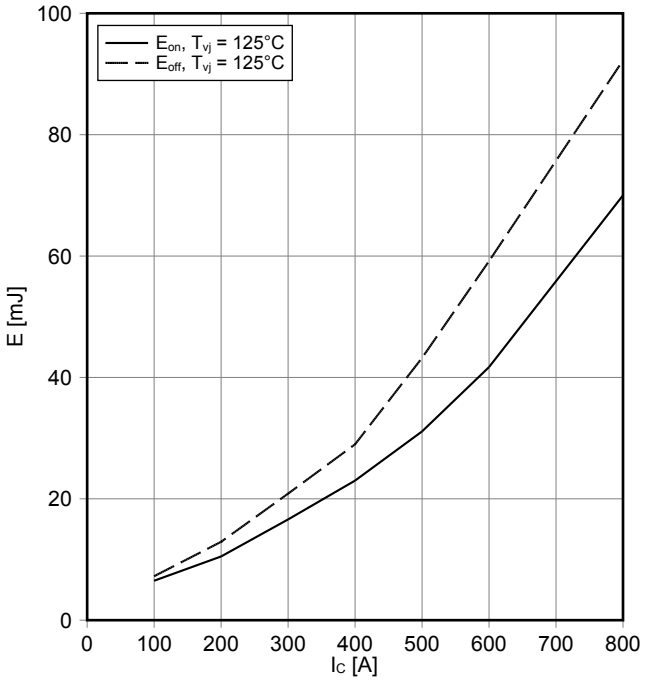
Ausgangskennlinienfeld IGBT,Wechselrichter (typisch)
output characteristic IGBT,Inverter (typical)
$I_C = f(V_{CE})$
T_{vj} = 125°C



Übertragungscharakteristik IGBT,Wechselrichter (typisch)
transfer characteristic IGBT,Inverter (typical)
$I_C = f(V_{GE})$
V_{CE} = 20 V



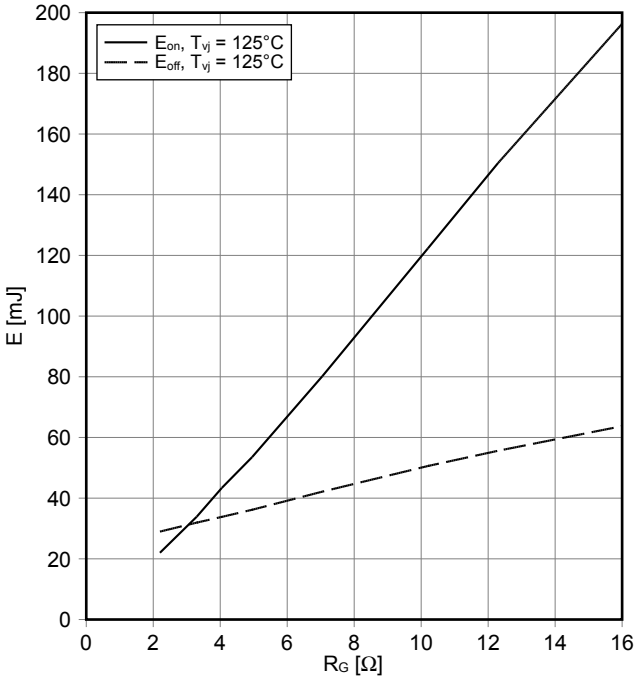
Schaltverluste IGBT,Wechselrichter (typisch)
switching losses IGBT,Inverter (typical)
$E_{on} = f(I_C)$, $E_{off} = f(I_C)$
V_{GE} = ±15 V, R_{Gon} = 2.2 Ω, R_{Goff} = 2.2 Ω, V_{CE} = 600 V



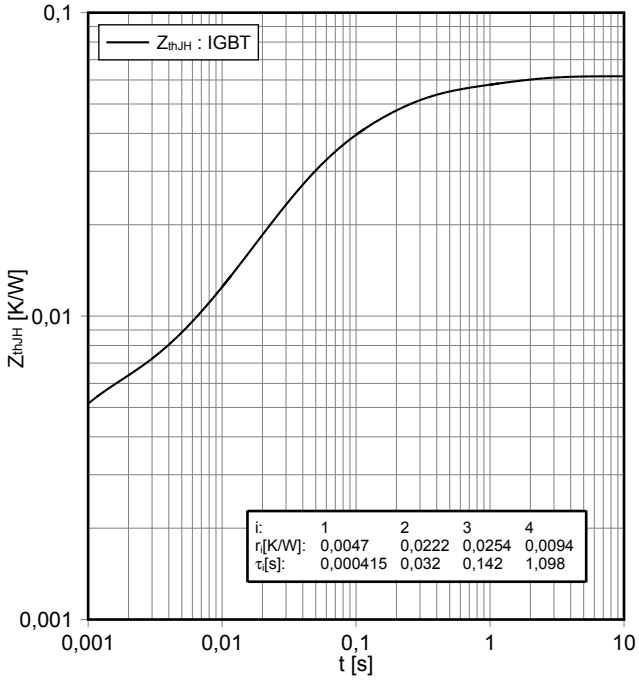
prepared by: AKB	date of publication: 2016-06-14
approved by: MK	revision: V2.0

Vorläufige Daten
Preliminary Data

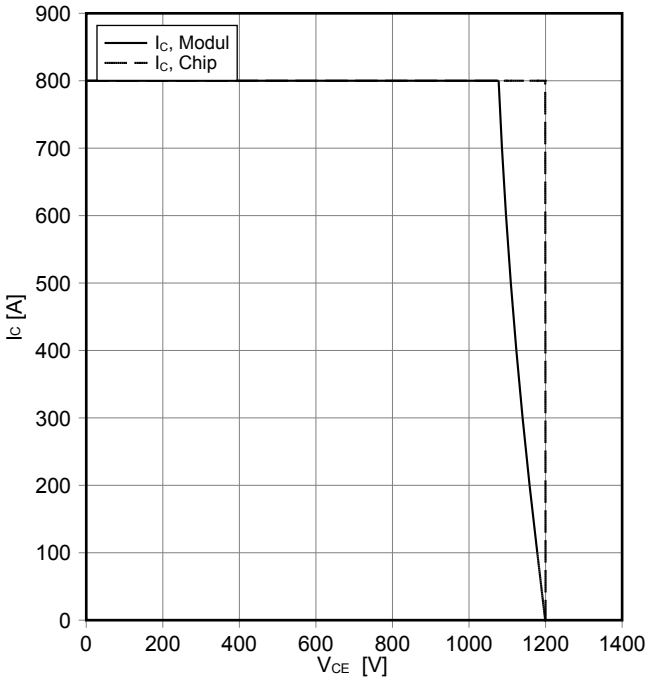
Schaltverluste IGBT,Wechselrichter (typisch)
switching losses IGBT,Inverter (typical)
$E_{on} = f(R_G)$, $E_{off} = f(R_G)$
V_{GE} = ±15 V, I_C = 400 A, V_{CE} = 600 V



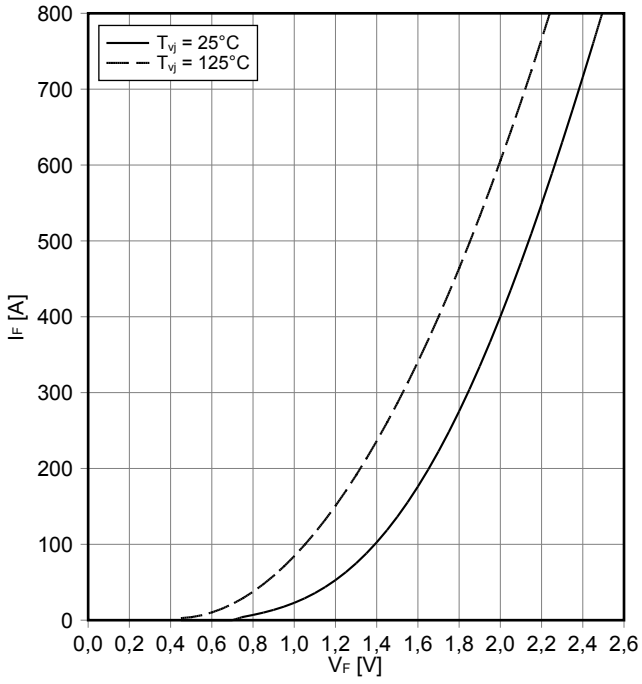
Transienter Wärmewiderstand IGBT,Wechselrichter
transient thermal impedance IGBT,Inverter
$Z_{thJH} = f(t)$



Sicherer Rückwärts-Arbeitsbereich IGBT,Wechselrichter (RBSOA)
reverse bias safe operating area IGBT,Inverter (RBSOA)
$I_C = f(V_{CE})$
V_{GE} = ±15 V, R_{Goff} = 2.2 Ω, T_{vj} = 125°C



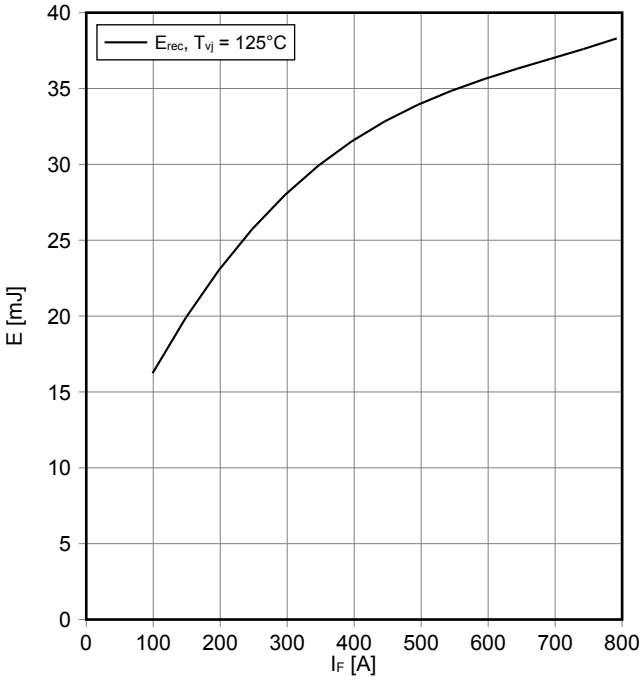
Durchlasskennlinie der Diode, Wechselrichter (typisch)
forward characteristic of Diode, Inverter (typical)
$I_F = f(V_F)$



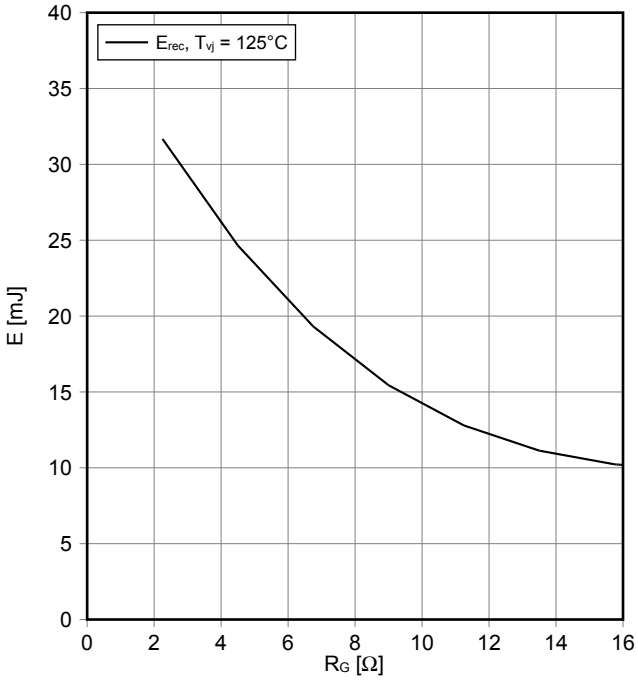
prepared by: AKB	date of publication: 2016-06-14
approved by: MK	revision: V2.0

Vorläufige Daten
Preliminary Data

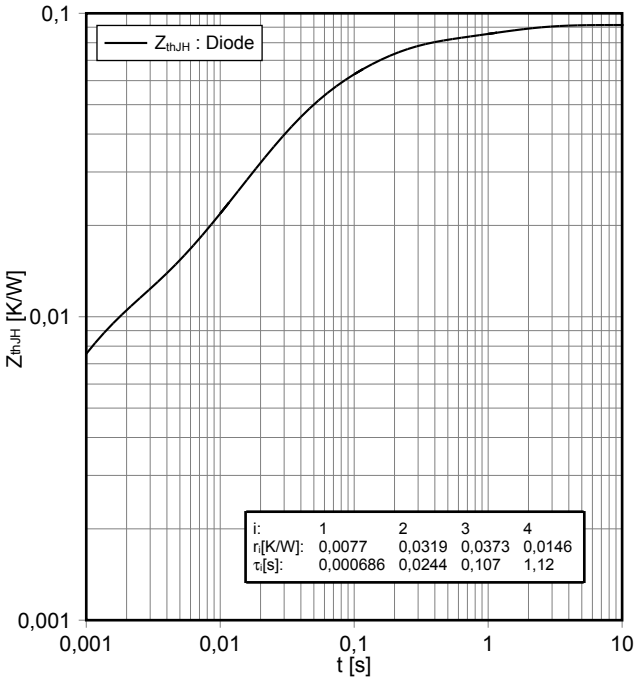
Schaltverluste Diode, Wechselrichter (typisch)
switching losses Diode, Inverter (typical)
$E_{rec} = f(I_F)$
$R_{Gon} = 2.2\ \Omega$, $V_{CE} = 600$ V



Schaltverluste Diode, Wechselrichter (typisch)
switching losses Diode, Inverter (typical)
$E_{rec} = f(R_G)$
$I_F = 400$ A, $V_{CE} = 600$ V



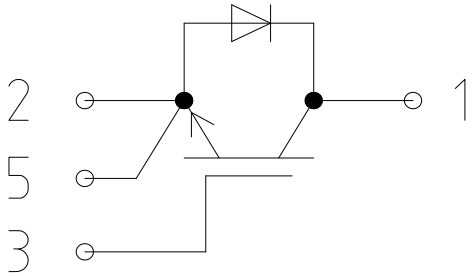
Transienter Wärmewiderstand Diode, Wechselrichter
transient thermal impedance Diode, Inverter
$Z_{thJH} = f(t)$



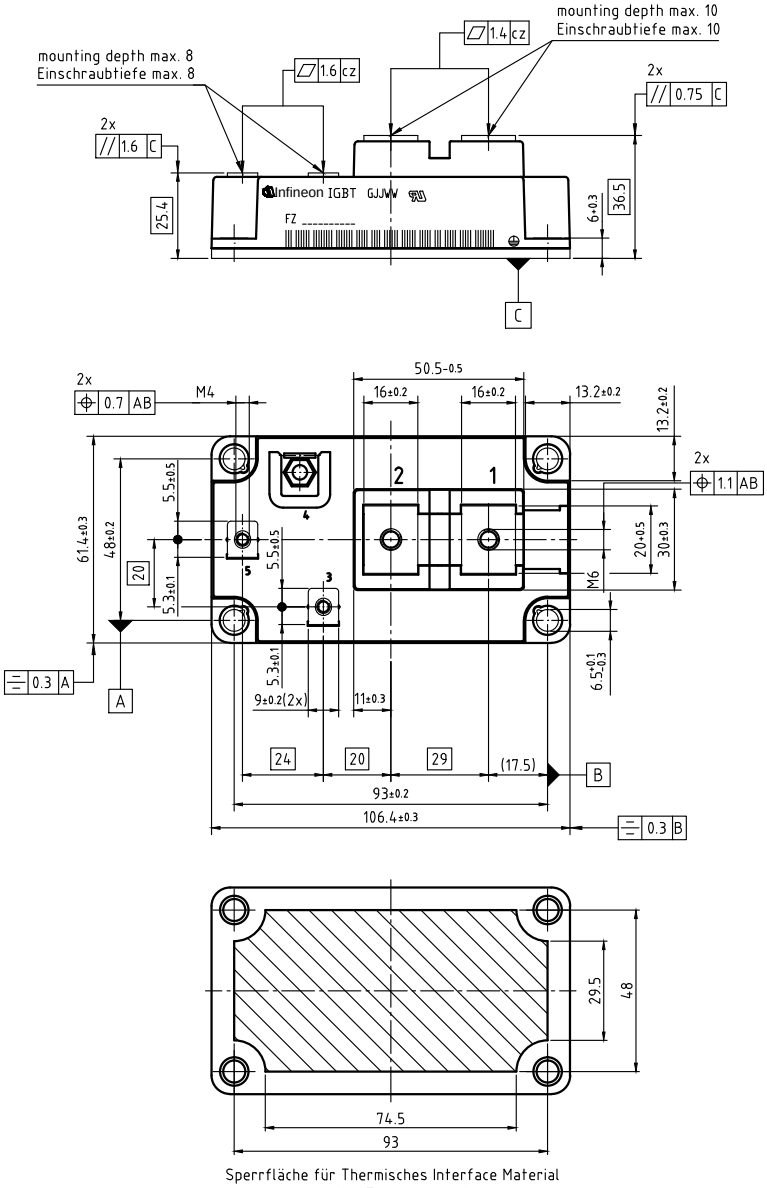
prepared by: AKB	date of publication: 2016-06-14
approved by: MK	revision: V2.0

Vorläufige Daten
Preliminary Data

Schaltplan / Circuit diagram



Gehäuseabmessungen / Package outlines



Sperrfläche für Thermisches Interface Material
restricted area for Thermal Interface Material

prepared by: AKB	date of publication: 2016-06-14
approved by: MK	revision: V2.0

Vorläufige Daten
Preliminary Data

Published by
Infineon Technologies AG
81726 München, Germany
© Infineon Technologies AG 2015.
All Rights Reserved.

Nutzungsbedingungen

WICHTIGER HINWEIS

Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keinesfalls Garantien für die Beschaffenheit oder Eigenschaften des Produktes ("Beschaffenheitsgarantie") dar. Für Beispiele, Hinweise oder typische Werte, die in diesem Dokument enthalten sind, und/oder Angaben, die sich auf die Anwendung des Produktes beziehen, ist jegliche Gewährleistung und Haftung von Infineon Technologies ausgeschlossen, einschließlich, ohne hierauf beschränkt zu sein, die Gewähr dafür, dass kein geistiges Eigentum Dritter verletzt ist.

Des Weiteren stehen sämtliche, in diesem Dokument enthaltenen Informationen, unter dem Vorbehalt der Einhaltung der in diesem Dokument festgelegten Verpflichtungen des Kunden sowie aller im Hinblick auf das Produkt des Kunden sowie die Nutzung des Infineon Produktes in den Anwendungen des Kunden anwendbaren gesetzlichen Anforderungen, Normen und Standards durch den Kunden.

Die in diesem Dokument enthaltenen Daten sind ausschließlich für technisch geschultes Fachpersonal bestimmt. Die Beurteilung der Eignung dieses Produktes für die beabsichtigte Anwendung sowie die Beurteilung der Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Produktdaten für diese Anwendung obliegt den technischen Fachabteilungen des Kunden.

Sollten Sie von uns weitere Informationen im Zusammenhang mit dem Produkt, der Technologie, Lieferbedingungen bzw. Preisen benötigen, wenden Sie sich bitte an das nächste Vertriebsbüro von Infineon Technologies (www.infineon.com).

WARNHINWEIS

Aufgrund der technischen Anforderungen können Produkte gesundheitsgefährdende Substanzen enthalten. Bei Fragen zu den in diesem Produkt enthaltenen Substanzen, setzen Sie sich bitte mit dem nächsten Vertriebsbüro von Infineon Technologies in Verbindung.

Sofern Infineon Technologies nicht ausdrücklich in einem schriftlichen, von vertretungsberechtigten Infineon Mitarbeitern unterzeichneten Dokument zugestimmt hat, dürfen Produkte von Infineon Technologies nicht in Anwendungen eingesetzt werden, in welchen vernünftigerweise erwartet werden kann, dass ein Fehler des Produktes oder die Folgen der Nutzung des Produktes zu Personenverletzungen führen.

Terms & Conditions of usage

IMPORTANT NOTICE

The information given in this document shall in no event be regarded as a guarantee of conditions or characteristics ("Beschaffenheitsgarantie"). With respect to any examples, hints or any typical values stated herein and/or any information regarding the application of the product, Infineon Technologies hereby disclaims any and all warranties and liabilities of any kind, including without limitation warranties of non-infringement of intellectual property rights of any third party.

In addition, any information given in this document is subject to customer's compliance with its obligations stated in this document and any applicable legal requirements, norms and standards concerning customer's products and any use of the product of Infineon Technologies in customer's applications.

The data contained in this document is exclusively intended for technically trained staff. It is the responsibility of customer's technical departments to evaluate the suitability of the product for the intended application and the completeness of the product information given in this document with respect to such application.

For further information on the product, technology, delivery terms and conditions and prices please contact your nearest Infineon Technologies office (www.infineon.com).

WARNINGS

Due to technical requirements products may contain dangerous substances. For information on the types in question please contact your nearest Infineon Technologies office.

Except as otherwise explicitly approved by Infineon Technologies in a written document signed by authorized representatives of Infineon Technologies, Infineon Technologies' products may not be used in any applications where a failure of the product or any consequences of the use thereof can
reasonably be expected to result in personal injury.

prepared by: AKB	date of publication: 2016-06-14
approved by: MK	revision: V2.0

Unikeyic Electronics

Global Electronic Components Distributor

Click to view pricing, inventory, delivery, and lifecycle information:

Infineon Technologies:

FP150R12N3T4PB81BPSA1 BGM781N11E6327XUSA1 FS100R12KT4GPBPSA1 IPT014N08NM5ATMA1 IRF3710PBF TLE4971A120N5E0001XUMA1 TLS208D1EJV33XUMA1 ISZ75DP15LMATMA1 SPP06N80C3 TLE493DW2B6A0HTSA1 IM241S6S1BAUMA1 TLF80511TCATMA2 AIMW120R060M1HXKSA1 BTS 5210 G IGCM10F60GAXKMA1 BAT5405WH6327XTSA1 CY8C29466-24PVXI IPL60R185C7AUMA1 CY8C24894-24LTXI IPB320P10LMATMA1 IPD60R650CEAUMA1 BSZ050N03LSGATMA1 FS75R12KE3B9BOSA1 IKD10N60RFATMA1 XMC4800F144K1024AAXQMA1 TC1782F320F180HRBAKXUMA2 2EDS8265HXUMA2 BSC320N20NS3 G BTS70302EPADAUGHBRDTOBO1 EVALPMG1B1DRPTOBO1